

DIN EN 61837-1



ICS 31.240

Ersatz für
DIN EN 61837-1:1999-12
Siehe Anwendungsbeginn

**Oberflächenmontierbare piezoelektrische Bauteile zur
Frequenzstabilisierung und -selektion –
Norm-Gehäusemaße und Anschlüsse –
Teil 1: Kunststoffgehäuse
(IEC 61837-1:2012);
Deutsche Fassung EN 61837-1:2012**

Surface mounted piezoelectric devices for frequency control and selection –
Standard outlines and terminal lead connections –
Part 1: Plastic moulded enclosure outlines
(IEC 61837-1:2012);
German version EN 61837-1:2012

Dispositifs piézoélectriques à montage en surface pour la commande et le choix de la
fréquence –
Encombrements normalisés et connexions des sorties –
Partie 1: Encombrements des enveloppes en plastique moulées
(CEI 61837-1:2012);
Version allemande EN 61837-1:2012

Gesamtumfang 24 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE

Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn für die von CENELEC am 2012-05-25 angenommene Europäische Norm als DIN-Norm ist 2012-12-01.

Für DIN EN 61837-1:1999-12 gilt eine Übergangsfrist bis zum 2015-05-25.

Nationales Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN IEC 61837-1:2009-05.

Für diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 642 „Piezoelektrische Bauteile zur Frequenzstabilisierung und -selektion“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zuständig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 49 „Piezoelectric and dielectric devices for frequency control and selection“ erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (stability date) unverändert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter „<http://webstore.iec.ch>“ zu dieser Publikation angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

- bestätigt,
- zurückgezogen,
- durch eine Folgeausgabe ersetzt oder
- geändert.

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein Zusammenhang besteht, grundsätzlich über die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europäische Norm durch CENELEC übernommen und als DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 61837-1:1999-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Alle Abschnitte wurden unter Berücksichtigung des gesamten Inhalts der vorherigen Ausgabe entsprechend den aktuellen Anforderungen an Form und Gestaltung überarbeitet.
- b) Die Gehäusebauform SIP-L5/01 wurde gestrichen.
- c) Die Konfigurationssymbole der Gehäuse wurden in dem einen Symbol DCC (dual chip carrier) zusammengefasst.

Frühere Ausgaben

DIN EN 61837-1: 1999-12

Oberflächenmontierbare piezoelektrische Bauteile zur
Frequenzstabilisierung und -selektion –
Norm-Gehäusemaße und Anschlüsse –
Teil 1: Kunststoffgehäuse
(IEC 61837-1:2012)

Surface mounted piezoelectric devices for
frequency control and selection –
Standard outlines and terminal lead connections –
Part 1: Plastic moulded enclosure outlines
(IEC 61837-1:2012)

Dispositifs piézoélectriques à montage en
surface pour la commande et le choix de la
fréquence –
Encombrements normalisés et connexions des
sorties –
Partie 1: Encombrements des enveloppes en
plastique moulées
(CEI 61837-1:2012)

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 2012-05-25 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC Management Centre oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem CEN-CENELEC Management Centre mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.

CENELEC

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brüssel

© 2012 CENELEC – Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 61837-1:2012 D

Vorwort

Der Text des Dokuments 49/930/CDV, zukünftige 2. Ausgabe der IEC 61837-1, erarbeitet vom IEC/TC 49 „Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection“, wurde zur parallelen IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als EN 61837-1:2012 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

- spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene durch Veröffentlichung einer identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung übernommen werden muss (dop): 2013-02-25
- spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN entgegenstehen, zurückgezogen werden müssen (dow): 2015-05-25

Dieses Dokument ersetzt EN 61837-1:1999.

EN 61837-1:2012 enthält die folgenden wesentlichen technischen Änderungen gegenüber EN 61837-1:1999:

- Die Gehäusebauform SIP-L5/01 wurde gestrichen;
- die Konfigurationssymbole der Gehäuse wurden in dem einen Symbol DCC (dual chip carrier) zusammengefasst.

Dieses Dokument sollte zusammen mit EN 61240:1997 angewendet werden.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61837-1:2012 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abänderung als Europäische Norm angenommen.

Inhalt

	Seite
Vorwort	2
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Konfiguration der Gehäuse	4
4 Bezeichnung der Bauformen	4
5 Maße der Kunststoffgehäuse	4
6 Anschlussbelegungen	5
7 Kunststoffgehäuse	5
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen	22
Tabelle 1 – Bezeichnung der Kunststoffgehäuse	5

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von IEC 61837 basiert auf IEC 61240 und beschreibt Norm-Gehäusemaße und Anschlüsse, wie sie für oberflächenmontierbare Bauelemente (SMD) zur Frequenzstabilisierung und -selektion in Kunststoffgehäusen gelten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

IEC 61240:1994, *Piezoelectric devices – Preparation of outline drawings of surface-mounted devices (SMD) for frequency control and selection – General rules* ¹⁾

3 Konfiguration der Gehäuse

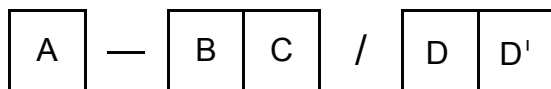
Diese Gehäuse sind aus einem Kunststoff-Vergussmaterial hergestellt, wobei ihre Anschlüsse auf dem beschreibenden Kennzeichnungssystem für Halbleitergehäuse basieren.

Das Konfigurationssymbol ist wie folgt:

- DCC (dual chip carrier)

4 Bezeichnung der Bauformen

Die Bezeichnung der Bauformen setzt sich aus den folgenden vier Teilen zusammen:



A: Konfigurationssymbol der Gehäuse:

- DCC (dual chip carrier);

B: Struktur der Anschlussdrähte:

- J: bedrahtete Bauform;

C: Anzahl der Anschlussdrähte;

D: zweistellige Seriennummer.

5 Maße der Kunststoffgehäuse

Die in dieser Norm angegebenen Maße gelten für alle fertiggestellten SMD-Bauteile zur Frequenzstabilisierung und -selektion. Nur die Maße sind angegeben, die die Anforderungen der IEC 61240 erfüllen.

¹⁾ Eine neue Ausgabe ist in Vorbereitung.

6 Anschlussbelegungen

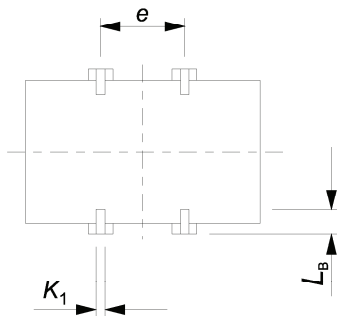
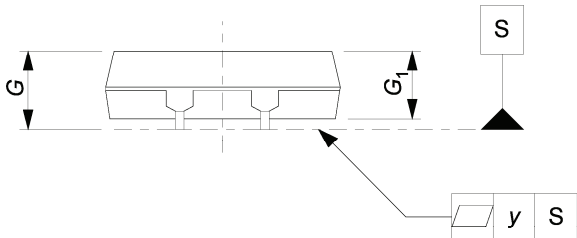
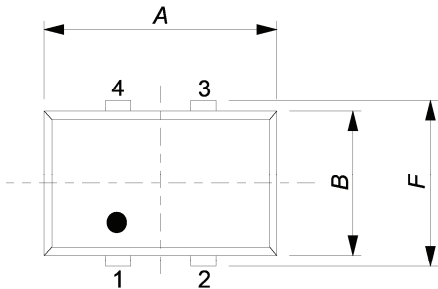
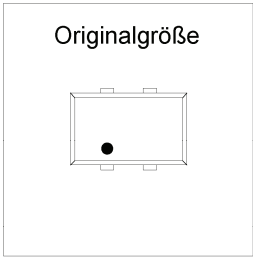
Empfehlungen für die Belegung der Anschlüsse aller fertiggestellten SMD-Bauteile zur Frequenzstabilisierung und -selektion sind in den folgenden Blättern angegeben. Anschlussbelegungen müssen immer in der Bauartspezifikation angegeben werden.

7 Kunststoffgehäuse

In Tabelle 1 sind die Bezeichnungen der in den nachfolgenden Spezifikationsblättern dargestellten Kunststoffgehäuse angegeben.

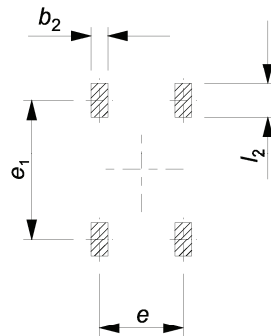
Tabelle 1 – Bezeichnung der Kunststoffgehäuse

Nr.	Bauform	Blatt-Nr.	Beschreibung
1	DCC-J4/01	Blatt 1	Kunststoff, umspritzt, vier gebogene Anschlüsse für SMD-Montage
2	DCC-J4/02	Blatt 2	Kunststoff, umspritzt, vier gebogene Anschlüsse für SMD-Montage
3	DCC-J4/03	Blatt 3	Kunststoff, umspritzt, vier gebogene Anschlüsse für SMD-Montage
4	DCC-J4/04	Blatt 4	Kunststoff, umspritzt, vier gebogene Anschlüsse für SMD-Montage
5	DCC-J4/05	Blatt 5	Kunststoff, umspritzt, vier gebogene Anschlüsse für SMD-Montage
6	DCC-J4/06	Blatt 6	Kunststoff, umspritzt, vier gebogene Anschlüsse für SMD-Montage
7	DCC-J4/07	Blatt 7	Kunststoff, umspritzt, vier gebogene Anschlüsse für SMD-Montage
8	DCC-J4/08	Blatt 8	Kunststoff, umspritzt, vier gebogene Anschlüsse für SMD-Montage

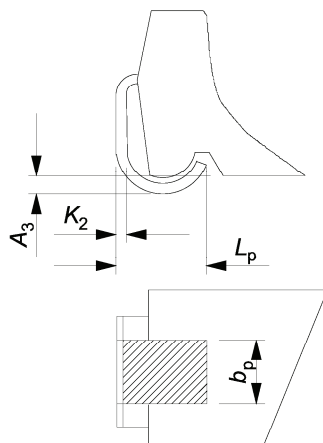


Bezug	Maße in mm			Bemer- kungen
	min.	nenn.	max.	
A			14,00	
B			8,90	
G			4,70	
G ₁			4,20	
K ₁	0,40		0,60	
K ₂	0,20		0,30	
F	9,40		9,80	
L _B	1,70		2,10	
e		5,08		
e ₁		7,62		
b ₂			0,80	
l ₂			2,30	
y			0,10	
A ₃		0,30		
b _p	0,40		0,60	
L _p	1,00		1,60	

Anschlussflächen



Anschlusskonfiguration



Kunststoff, umspritzt, vier gebogene Anschlüsse für SMD-Montage,
Bauform DCC-J4/01

Maßstab
2:1

